

이 보고서는 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서

 YouTube 요약 영상 보러가기

성우테크론(045300)

반도체

요약

기업현황

재무분석

주요 변동사항 및 전망



작성기관

한국기업데이터(주)

작성자

양기보 전문위원

- 본 보고서는 「코스닥 시장 활성화를 통한 자본시장 혁신방안」의 일환으로 코스닥 기업에 대한 투자정보 확충을 위해, 한국거래소와 한국예탁결제원의 후원을 받아 한국IR협의회가 기술신용평가기관에 발주하여 작성한 것입니다.
- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 카카오톡에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3215-2398)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

성우테크론(045300)

공정 자동화 기술력 확보를 통한 반도체 소부장 업체로서의 위상 강화

기업정보(2021/07/12 기준)

대표자	박찬홍
설립일자	1997년 4월 1일
상장일자	2001년 12월 14일
기업규모	중소기업
업종분류	반도체 제조용 기계 제조업
주요제품	리드프레임, 반도체 장비 외

시세정보(2021/07/12 기준)

현재가(원)	6,390
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	613억 원
발행주식수(주)	9,586,649
52주 최고가(원)	8,673
52주 최저가(원)	3,492
외국인지분율	0.97%
주요주주	박찬홍, 하명주

■ 반도체 관련 부품 임가공, 검사 및 장비 제조 전문기업

성우테크론(주)은 1997년 4월 1일 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조를 목적으로 설립된 후, 2001년 12월 14일 코스닥 시장에 상장된 기업으로서, 총괄적으로 장비 사업, 부품 사업, PCB 사업, TR 사업 등을 영위하고 있다. 동사의 종속기업으로 성우세미텍 주식회사가 있으며, 반도체 부품 제조업을 주업으로 하고 있다.

■ 검사장비 제조, 후공정 가공, PCB 가공, 검사 등 우수한 기술력 보유

반도체 부품 후공정 가공, 임가공 및 반도체 부품 2D, 3D 검사를 위한 장비를 생산하고 있으며, 제조하고 있는 검사장비는 이미지시스템을 활용한 추출 이미지를 대조하여 분석, 판정을 진행할 수 있으며, 제조 데이터 수집, 구축 및 공정 모니터링을 통한 생산 공정에 실시간으로 수치 반영하여 업체 요구 사항에 대응할 수 있어 기술경쟁력을 보유하고 있다.

■ 차세대 검사장비 개발을 통해 반도체 제품 시장변화에 대응 중

메모리 반도체 시장은 컴퓨터, 스마트폰, 서버 등 증장기 수요 공급이 증가하는 점에 따라 시장규모가 증가되고 있어 적합품을 등 품질 경쟁력과 적기에 제품을 공급할 수 있는 투자에 따라 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다.

성우테크론(주)은 차세대 인공지능(AI) 딥러닝을 적용한 검사장비를 개발하였고, 기술개발을 위한 기업부설연구소 운영과 생산 설비 투자를 통해 경반단소 시장에 대응할 수 있어 시장 경쟁력을 높이고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

구분 년	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018	395	3.4	72	18.2	54	13.7	12.1	7.6	50.3	560	5,006	7.0	0.8
2019	329	-16.7	22	6.7	46	13.8	9.4	6.3	48.2	472	5,450	8.8	0.8
2020	379	15.2	43	11.4	39	10.2	7.4	5.0	48.2	399	5,805	11.9	0.8

기업경쟁력

특허경영

- 특허권, 상표권 등 다수 지식재산권 보유
 - 검사용 지그장치, 광학 검사장치 등

반도체장비 기술력 보유

- 패키지 프로세스에 사용되는 반도체의 부품 임가공
- 반도체 관련 인공지능(AI) 딥러닝 검사장비 개발

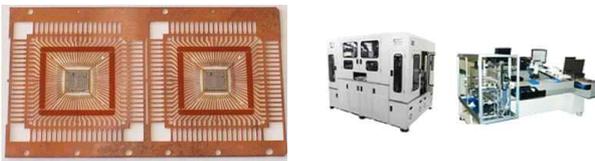
핵심기술 및 적용제품

핵심기술

- 인공지능(AI) 딥러닝 검사 알고리즘을 적용한 차세대 인공지능(AI) 딥러닝 검사장비 개발 및 고집적 PCB회로 분석

적용제품

- 리드프레임
- 반도체 검사장비 등



매출실적

- 사업부문별 매출 현황 (단위 : 억 원)

부문	2018년	2019년	2020년	2021년 1분기
장비사업부	125	94	152	32
부품사업부	171	147	136	41
PCB사업부	86	77	78	19
TR사업부	14	12	13	5
합계	395	329	379	97

시장현황

목표시장 내 경쟁력

- D램 시장은 2015년 346,544억 원에서 연평균 36.3%으로 성장하여 2018년 877,312억 원을 기록
- 전방 산업의 선도 기업들과 긴밀한 거래관계 형성 중
- 중저가 스마트폰, 산업용, 자동차용 반도체를 겨냥한 리드프레임 후공정 가공 및 검사장비 제조 능력 보유

최근 변동사항

정부의 소부장 산업 강화 정책

- 2025년까지 소부장 으뜸기업 100개로 확대
- 소부장 특화단지를 지정하여 기업 역량 집중지원
- 동사는 창원 소부장 특화단지에 속해 수혜 전망

사무자동화 및 생산성 향상에 주력

- IoT, 인공지능을 적용한 차세대 스마트 공장 구축
- 라인스캔 촬영기, ICS 불량 활상 검사장치, IIS 이미지 확인 시스템 등 설비구축을 통한 생산성 향상에 주력

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황

ESG	Issue	Action	SDGs
 ENVIRONMENTAL	- 에너지, 온실가스(탄소 배출) 이슈 - 산업구조 공정간 물 사용, 폐기물 배출 등의 환경 이슈 - 환경 유해성 저감 활동	- ISO 14001 환경경영시스템 인증 및 '환경안전 관리' 규정 준수 - 공정 1차 폐수 공업용수로 재활용 처리 - 공정 오, 폐수 생태독성 저감 처리 후 방류	 6 CLEAN WATER AND SANITATION
 SOCIAL	- 장비 특성상 높은 신뢰성과 품질안정성 요구 - 조직문화, 직원 복지 및 근무환경 - 고용안정과 양질의 일자리 확보 - 정부 R&D 소부장 산업 강화 정책	- 대기업 중심 협력형태의 수요, 공급 파트너십 강화 및 밸류체인 추진 - 취업 준비생 대상 현장실습 직업교육 제공 - 금속노조와의 고용안정 및 일자리 제공 협약	 4 QUALITY EDUCATION
 GOVERNANCE	- 배당을 통한 주주가치 제고 - 이해관계자 소통을 위한 채널 다양성 확보 - 합리적인 의사결정 및 투명한 제도	- 지속적인 주식, 현금배당을 통한 주주가치에 환원 - 홈페이지를 통한 이해관계자 소통 운영 - 주주총회소집을 통해 원안 결정 후 의안 공개	 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

한국기업데이터(주)의 ESG 평가항목 기반 자체 데이터, 언론자료 및 제출자료 등을 통해 Issue와 Action을 구성하고 이를 SDGs와 연계

I. 기업현황

반도체장비 부품 가공, 리드프레임, PCB 검사 등 우수한 기술력을 보유한 기업

동사는 반도체와 관련된 초경량, 초미세제품에 대한 검사 알고리즘 연구, 개발을 통하여 차세대 인공지능(AI) 딥러닝 검사장비 개발을 하였고, 자체생산 장비를 이용하여 고집적 PCB회로를 분석하고 검사함으로써 품질의 신뢰성을 극대화시켜 지속적인 성장을 유지하고 있다.

■ 기업 개요

성우테크론(주) (이하 '동사')는 1997년 4월 1일 반도체 검사장비의 제조 및 반도체 부품 제조를 목적으로 설립된 후 2001년 12월 14일 코스닥 시장에 상장된 기업으로, 리드프레임 후 공정 가공 및 부품사업, 반도체용 기판을 검사하는 PCB 사업 및 반도체 제품 등을 임가공, 검사하는 관련 장비사업 등을 영위하고 있고, 다수의 국내, 해외 거래처를 확보하고 있다. 그리고 동사의 종속기업으로는 2006년 1월에 설립된 성우세미텍 주식회사(이하 '종속기업')가 있고, 종속기업은 반도체 TR 및 반도체 IC 부품 제조업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 동사는 현재 종속기업의 지분 86.76%를 보유하고 있다.

동사는 2021년 3월 말 기준 245명의 직원이 근무하고 있으며, 동사의 대표이사 박찬홍(남)은 경남대학교 전자공학과를 졸업하였고, 한화테크윈(주)(1981 ~ 1993, 최종직위: 자동화설계팀 팀장)에서 근무한 경험을 바탕으로 1993년 4월에 동사의 전신인 개인기업 성우정밀을 개업하고 운영하다가 1997년 4월 현 상호로 법인 전환하여 현재까지 경영전반을 총괄하고 있다.

동인은 1984년 12월 삼성그룹 이건희 회장 표창을 받았고, 2001년 2월 이달의 벤처기업인 상을 수상한 이력이 있으며, 반도체의 회로연결과 열 방출 및 지지기능을 담당하는 반도체 리드프레임 관련 장비의 국산화를 성공시키고 이를 적용하여 제4회 경남중기대상 벤처창업부문 상을 받았다. 2021년 1분기 말 기준 동사의 지분 19.73%를 보유하고 있어 안정적인 지분구조를 확보하고 있다.

[표 1] 사업부문별 현황

구분	부문	사업내용	주요고객
성우테크론	장비사업부	LOC, PCB 검사장비	삼성전기, 엘지이노텍, 엘지에너지솔루션, 해성DS(주)
	부품사업부	메모리 칩 핵심부품, PC, TV, 항공기, 자동차 등	해성DS(주)
	PCB사업부	메모리 칩 핵심부품, 스마트 폰, 휴대폰 등	삼성전기, 심텍
성우세미텍 주식회사	TR사업부	트랜지스터 핵심부품	해성DS(주), PSMC

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 반도체부품 임가공, 검사 및 반도체 검사장비 제조 기술력 보유

동사는 자동화 시스템 분야에서 풍부한 경험을 바탕으로 구성되어 있는 노하우를 통해 초경량, 초미세제품에 대한 검사 알고리즘에 대하여 연구, 개발을 진행하였고, 차세대 인공지능(AI) 딥러닝이 적용된 검사장비를 제조하고 있다.

그리고 동사는 리드프레임을 생산하기 위하여 고정밀 금형 부품을 초정밀 설비로 가공하여 고품질의 금형을 설계 및 제조하고 있고, 이러한 설비의 내마모성을 향상시키기 위한 초경합금소재를 적용하여 금형을 제작하여 생산제품의 완성도를 제고하였으며, 리드프레임의 생산 공정의 효율성을 위하여 생산설비를 직접 제작하는 등의 기술력을 보유하고 있다.

[그림 1] 동사의 반도체 검사장비 등



*출처 : 동사 홈페이지

추가적으로, PCB는 용도에 따라 부품 실장용 기판과 반도체를 메인보드에 실장하기 위해 보조 역할을 하는 반도체 실장용 기판으로 분류하고 있고, 부품 실장용 기판은 전자기기의 기능 구현을 위해 반도체 칩, 개별소자, 기타 전자부품 등을 장착하는데 사용되는데, 동사는 동업중 오랜 경험과 기술 노하우를 바탕으로 거래처로부터 PCB 검사 공정을 위탁받아 D램 결손, 솔더 마스크 균열, 미 도금, 범프 불량, 마킹 위치 및 방법 등 외관 결함을 검사하고, 제품 최종 세정공정으로 PCB의 오염 및 이물질을 제거할 수 있는 기술력을 보유하고 있다.

[그림 2] 동사의 공정 과정(리드프레임, 보드 온 칩)



*출처 : 동사 홈페이지

II. 재무분석

글로벌 경기 개선과 반도체 업황 호조에 따른 수주증가로 매출성장 전망

동사는 전방 반도체 업황의 호조, PCB 수요 증가 등으로 반도체장비, LOC임가공, PCB 임가공 수주 증가하였으며, 오랜 업력을 바탕으로 축적된 우수한 기술력을 갖추어 거래안정성이 우수한 대기업 위주의 고정거래처 확보하고 있다.

■ 반도체 산업의 고성능화 및 복합화에 따른 수익성과 함께 지속적인 성장예상

동사는 반도체 관련 장비, LOC외주가공, PCB최종검사, TR가공 등의 생산, 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 반도체장비, 부품 제조 전문기업으로, 반도체부품 가공, 검사장비는 반도체 제품의 짧은 수명주기로 인해 다기능성 가공이 가능하면서도 고도의 분석력이 필수조건으로 하는데, 동사는 첨단정밀메카트로닉스 기술과 비전 기술을 확대 발전시킨 차세대 검사 알고리즘이 최적화된 기술을 구현하여 삼성전기, LS엠트론 등 다수의 거래처와 긴밀한 협업관계를 통해 다년간 안정적인 거래관계를 유지하고 있다.

한편 동사 매출의 80~90% 이상은 내수 판매를 통해 발생되고 있으며, 3개년 연결기준 매출실적은 2018년 395억 원, 2019년 329억 원, 2020년 379억 원으로, 전방산업인 반도체 업황에 따른 연도별 매출변동성 내재하고 있는 가운데 반도체 부품의 후공정 임가공 수주의 감소와 PCB 최종검사 임가공 수주 정체에도 반도체 부품의 최종검사 및 가공장비 수주 증가로 2020년 매출실적은 전년 대비 성장하였다.

또한 최근 반도체 산업의 고성능화 및 복합화가 진행됨에 따라 시장규모는 매년 지속적이고, 빠른 성장을 기록하여 왔으며, 반도체 산업의 치킨게임 결과 공급과잉이 조절되고 있고, 설비투자보다는 수익성 유지에 초점을 맞추면서 가격이 상승하며, 미국, 유럽 등 경기가 활성화되고 있어 수익성 증가와 함께 지속적인 외형성장이 예상된다.

[표 2] 유형별 매출실적 [K-IFRS 연결 기준]

(단위 : 억 원)

사업부문	매출유형		2018년	2019년	2020년	2021년 1분기
장비사업부	제품	수출	20	43	79	10
		내수	104	50	73	22
부품사업부	임가공	수출	-	-	-	-
		내수	171	147	136	41
PCB사업부	임가공	수출	-	-	-	-
		내수	86	77	78	19
TR사업부	임가공	수출	-	-	-	-
		내수	14	12	13	5
합계			395	329	379	97

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 매출증가 및 적절한 원가관리를 통한 수익성 향상

동사 2020년 결산기준 매출실적은 2019년 대비 15.2% 신장한 379억 원 시현하였고, 매출신

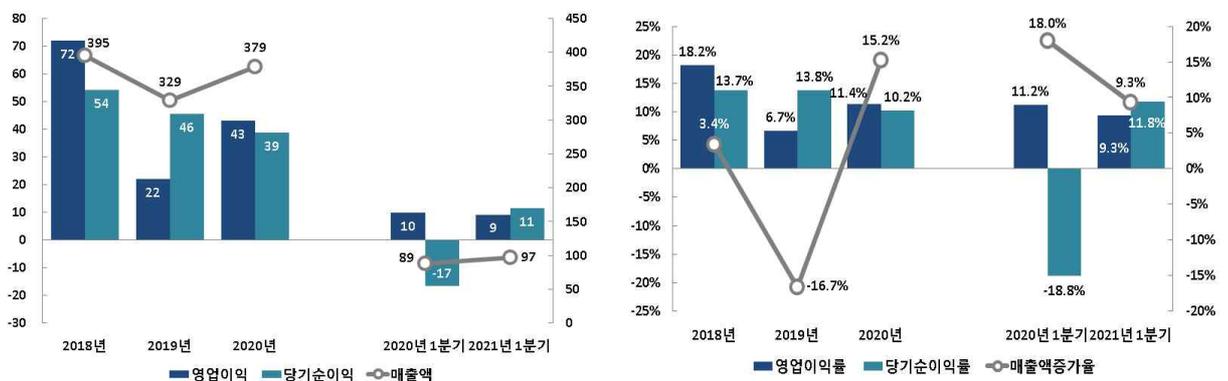
장 및 적절한 원가관리를 통해 매출총이익이 70억 원(전년도 48억 원)으로 급증하였으며, 판관비 부담 완화로 이익규모 확대 되어 같은 기간 영업이익은 43억 원으로 96% 증가하여 영업이익률 11.4% 기록하였으나, 영업 외 수지 저하로 순이익 39억 원, 순이익률은 10.2% 기록하여 전년도(13.7%) 대비 하락하였다.

한편, 반도체 검사장비의 기술을 접목하는 새로운 기술개발을 통해 관련 장비를 수주, 납품하였고, 휴대폰, 자동차 배터리 검사장비와 무선안테나용 검사장비 납품을 통해 2021년 1분기 기준 매출실적은 전년 동기(89억 원) 대비 9.3% 증가한 97억 원 시현하여 매출호조 지속되고 있는 가운데 영업이익 9억 원을 기록하였고, 순이익은 11억 원으로 전년 동기(-17억 원) 대비 흑자 전환하여 수익성 개선되었다.

또한, 반도체 업황이 호조 지속되고 있는 가운데 오랜 업력을 바탕으로 한 우수한 기술력 확보하고 있고, 이를 기반으로 주요수요처와 지속적인 거래관계 유지하고 있으며, 수출향상 및 품질안정, 공정안정 등으로 기회비용을 최소화함과 동시에 국내 반도체업체 투자확대 등을 감안 금년 추가적인 매출신장을 통한 수익성 확대가 전망된다.

[그림 3] 요약 포괄손익계산서 분석

(단위 : 억 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

[표 3] 주요 재무 현황 [K-IFRS 연결 기준]

(단위 : 억 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 1분기
매출액	395	329	379	97
영업이익	72	22	43	9
당기순이익	54	45	39	11
매출액증가율(%)	3.4	-16.7	15.2	9.3
영업이익률(%)	18.2	6.7	11.4	9.3
순이익률(%)	13.7	13.7	10.2	11.8
부채비율(%)	50.2	48.2	48.2	43.5

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

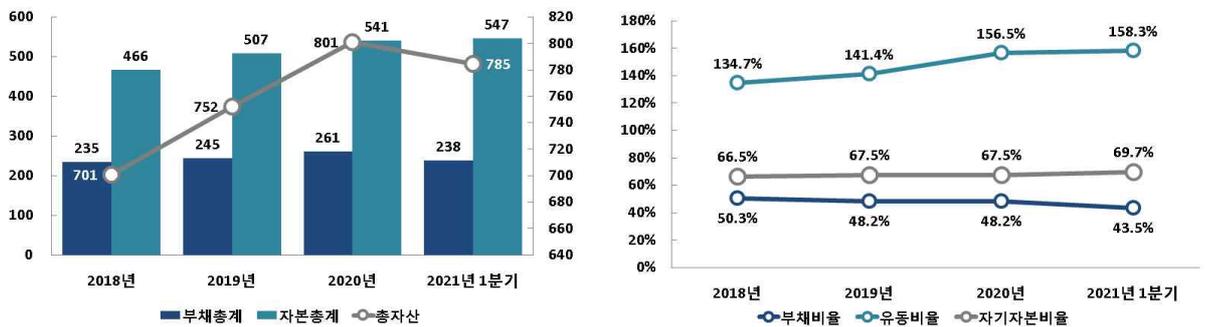
■ 풍부한 현금성 자산을 바탕으로 한 안정적인 재무구조 견지

동사는 연간 130억 원 내외의 차입금 운용 중에 있으며, 2020년 결산서 기준 부채비율 48.2%, 차입금의존도 18.8%로 업종평균(부채비율 183.6%, 차입금의존도 46.8%) 대비 낮은 수준이고, 이자보상배수 17배이고, 유보율 또한 수 개년 약 1,000%를 상회하는 안정적인 재무구조 견지하고 있다.

한편 2021년 1분기 기준 236억 원의 현금성 자산 보유하고 있으며, 부채비율 43.5%, 차입금의존도 16.6%, 이자보상배수 15.5배로 여전히 재무안정성 양호한 수준 지속되고 있고, 유동성 위험관리를 위해 단기 및 중장기 자금계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하고 있는바, 재무위험 가능성은 낮은 수준으로 판단된다.

[그림 4] 요약 재무상태표 분석

(단위 : 억 원)



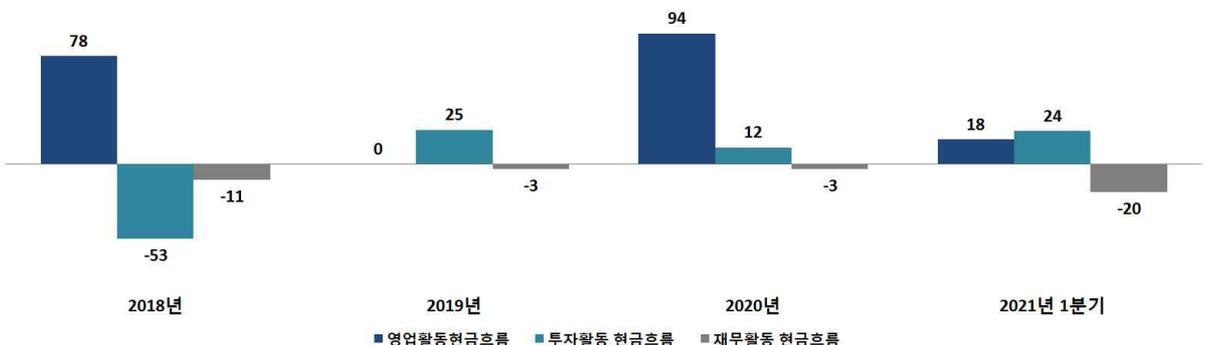
*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

동사 2020년 결산서 기준 매출채권 및 재고자산 증가 등에 따른 운전자본 부담 심화되었으나, 풍부한 현금유동성 및 영업수익성을 바탕으로 영업활동 조달현금은 정(+)의 상황이 지속되고, 투자활동으로 인한 현금유입액이 76억 원으로 유출액(64억 원)을 상회하고 있어 원활한 현금흐름 지속되고 있다.

한편 2021년 1분기 연결 기준 꾸준히 영업수익성 흑자 기조를 견지하여 영업활동현금흐름은 정(+)의 상황이 지속되고 있고, 단기금융상품 감소 등에 따른 현금유입액이 유출액을 24억 원 초과하고 있으며, 차입금일부 상환 등으로 재무활동현금흐름은 현금유출액이 유입액을 20억 원 초과하고 있다.

[그림 5] 현금흐름 분석

(단위 : 억 원)



*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

Ⅲ. 주요 변동사항 및 전망

설비 투자 및 차세대 검사장비 개발을 통한 시장 경쟁력 확보

동사는 추가 설비구축을 통한 생산성 향상에 주력하고, 인공지능(AI) 딥러닝을 적용한 검사장비 기술 개발을 통해 시장 대응 중이며, 장비 생산의 적시적소를 확보하여 시장 경쟁력 확보 및 시장 선점에 매진중이다.

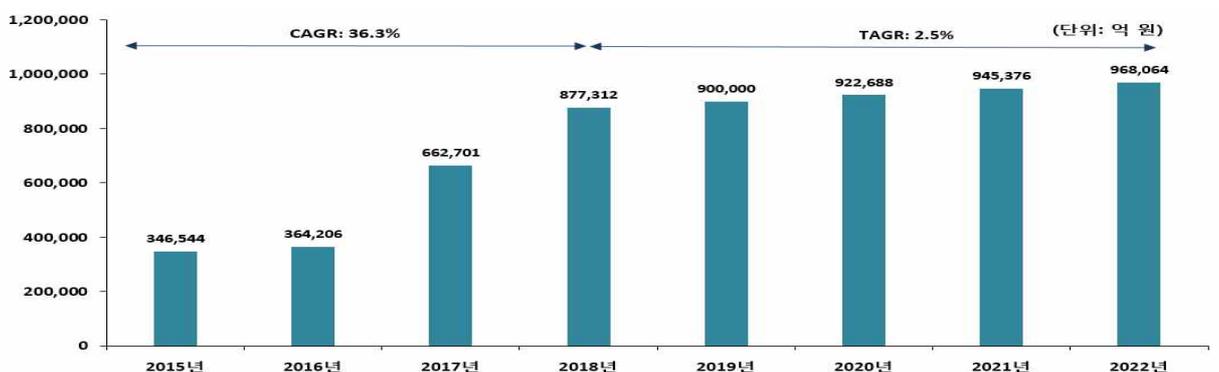
■ 반도체 D램 시장규모의 증가로 리드프레임, 반도체 검사장비 수요 증가 전망

한국수출입은행에서 발간한 ‘반도체산업 증장기 전망’ 이슈보고서에 따르면, 데이터 경제로의 전환 가속화, 인공지능(AI) 활용 확대 등으로 생산, 유통, 소비의 전 부문에 걸쳐 스마트화 및 비대면화 확산되고 있으며, 코로나19는 재택근무, 온라인 쇼핑 등 비대면 산업의 성장을 촉진하고 있고, 자율주행, 스마트시티 등 반도체 산업의 신수요가 창출되면서 반도체 수요는 중장기적으로 성장 전망이다.

그리고 반도체산업 성장의 축은 PC에서 2000년대 후반 스마트폰, 2010년대 후반 서버 등으로 이동했으며, 반도체 수요처도 IT기기에서 산업기기, 가전, 자동차 등으로 다변화되고 있고, 반도체 수요처 다변화, 위탁생산 확대 등으로 반도체산업의 경기순환 주기가 짧아지고 있어 호황과 불황의 폭도 축소되는 추세이다.

D램 시장은 2015년 34조 6,544억 원에서 연평균 36.3% 성장, 2018년 87조 7,312억 원 규모로 기록하였으며, 향후 2022년에는 96조 8,064억 원으로 역대 최대 규모를 기록할 전망이다. 메모리 반도체의 경우 우리나라 제조업체들이 세계 시장에서 과반을 점유 중으로 경쟁우위를 차지하고 있어 동사의 사업부문의 성장이 전망된다.

[그림 6] 국내 D램 시장규모 및 전망



*출처 : 한국과학기술정보연구원, 한국기업데이터(주) 재가공

■ 차세대 인공지능(AI) 딥러닝 검사장비 연구, 개발을 통해 변화하는 시장 대응

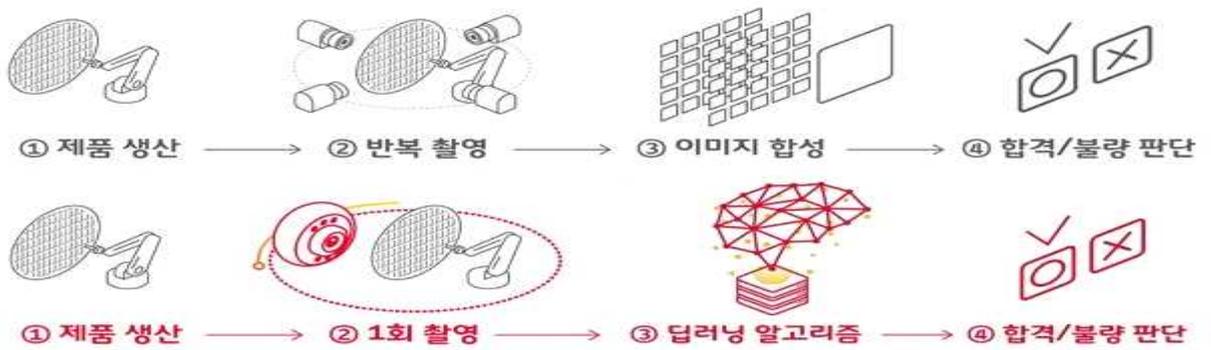
빅데이터, 인공지능(AI), 머신러닝 등에 최적화된 초고속, 고용량 제품인 DDR5의 경우 2020년 7월 표준 규격이 발표된 데 이어 2021년부터 관련 시장과 수요가 본격화될 전망이며, 고성능, 저전력을 구현하는 DDR5의 개발 속도에 따라 스마트폰, PC 뿐 아니라 서버 신규 수요와 교체

수요에 대응할 수 있는 기업의 경쟁력이 중요한 관건으로 전망된다.

D램 생산량과 중장기 수요, 공급이 증가하는 점에 따라 중장기적으로 반도체 관련 매출규모가 증가할 전망으로, 반도체 산업 전망에 따라 적합품률 등 품질 경쟁력과 적기에 제품을 공급할 수 있는 투자에 따라 시장 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 전망된다. 동사는 라인스캔 촬영기, ICS 불량 활상 검사장치, IIS 이미지 확인 시스템 등 추가 설비구축을 통한 생산성 향상에 주력하고 있어 향후 동사의 사업부문별 비중이 역시 증가할 것으로 기대되며, 동사의 관련 사업도 수혜를 입을 것으로 기대된다.

또한, 동사는 미국 코그넥스와의 협업을 통하여 장비 고도화 작업을 진행하고 있는데, 세부적으로, 검사 객체는 볼 검사, 마크 검사 같이 각 검사에 대한 객체이며 각각의 핵심 모듈이 나눠서 시퀀스 처리 엔진으로 들어가고 해당 핵심 부분들이 스케줄링 되어 이미지 전처리 모듈, 딥러닝 검사 등이 수행되면서 실행된다.

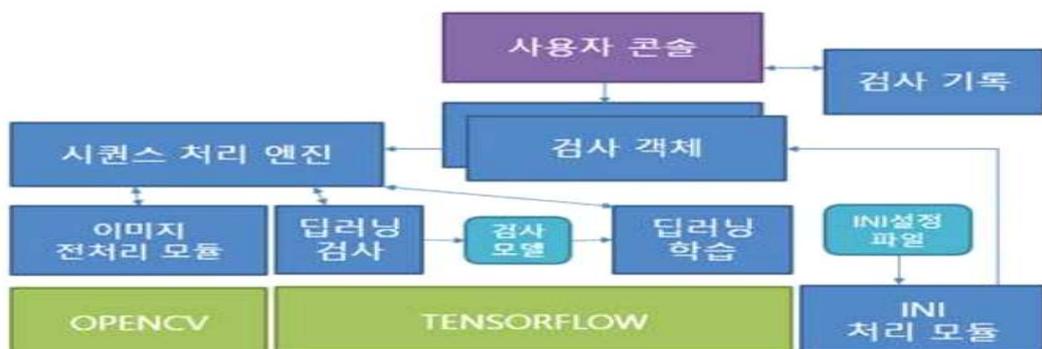
[그림 7] 이미지시스템 공정 과정(상: 기존, 하: 인공지능(AI) 딥러닝)



*출처 : SKT텔레콤(AI 솔루션 슈퍼노바), 한국기업데이터(주) 재가공

그리고 검사 결과에 대한 정보는 공유 메모리로 이루어진 시스템 인터페이스 통해 사용자 UI에 표출되고 제어부에 전달된다. 처리 엔진으로 들어가고 해당 핵심 부분들이 스케줄링 되어 이미지 전처리 모듈, 인공지능(AI) 딥러닝 검사 등이 수행되면서 실행된다. 실제 결과가 끝나면 해당 검사 모듈에서 콘솔로 사용자에게 결과를 보여주며 해당 결과는 별도의 결과 기록 모듈에 기록된다. 검사 결과에 대한 정보는 공유 메모리로 이루어진 시스템 인터페이스 통해 사용자 UI에 표출되고 제어부에 전달된다.

[그림 8] 인공지능(AI) 딥러닝 이미지시스템 구성



*출처 : 과학기술정보통신부

[표 4] 진행 중인 투자 설비 현황 (단위 : 백만 원)

순번	내용	투자기간	기투자액	투자효과
1	스마트공장 구축 및 고도화	2020.05.21~2021.5.21	69	사무자동화
2	성우대전 ICS 불량 촬상 장치, IIS이미지 확인 시스템	2020.10.01~2021.05.31	284	생산성향상
3	12K LINESCAN AVI	2021.02.01~2021.06.30	32	생산성향상
4	STACKER	2021.02.01~2021.06.30	32	생산성향상
계			417	

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

■ 기업부설연구소 중심의 R&D 역량 강화

동사의 주력 제품은 반도체 부품 및 반도체 장비로, 동사는 사업 초기부터 연구개발 투자를 통해 기술적 진입장벽을 구축하고 있는데, 2001년 4월부터 설립, 운영 중인 공인된 기업부설연구소(인정처 : 한국산업기술진흥협회) 내 전자공학 전문 인력 13명이 D램 반도체의 고속화에 따른 열적, 전기적 성능손실을 최소화할 수 있는 차세대 고속 반도체용 기판을 검사하는 기술, 반도체 부품 가공 기술, 2D, 3D 검사 장비 제조기술 등을 개발하고 있다.

동사의 최근 3개년(2018~2020년) 매출액 대비 R&D 투자비율 평균은 2.79%이며 기술 개발의 성과로 다수의 지식재산권을 출원, 등록하고 있는 등 동사는 기술력 확보를 통해 시장경쟁력을 강화하고 있는 것으로 판단된다.

[표 5] 연구개발비용 투자 현황 (단위 : 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년 1분기
연구개발비용 총계	1,175	960	942	252
연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계-당기 매출액 X 100]	2.97%	2.91%	2.49%	2.61%

*출처 : 동사 연도별 사업보고서, 분기보고서(2021년 3월), 한국기업데이터(주) 재가공

[표 6] 지식재산권 보유 현황 및 최근 연구개발실적 현황

구분	특허권	상표권	합계
	국내(출원 중)	국내	
보유 건수(개)	10(1)	4	14
연구과제	연구결과 및 기대효과		
프리미엄급 디스플레이를 위한 마이크로 LED 본딩용 소재 및 장비 기술 개발	라미네이션 공정에서 발생하는 Void, Warpage 현상을 제거하고 균일한 접착력 유지되도록 ACF 접합용 소재를 최적화 및 50 PPI급 마이크로 LED 광원 패널을 개발		

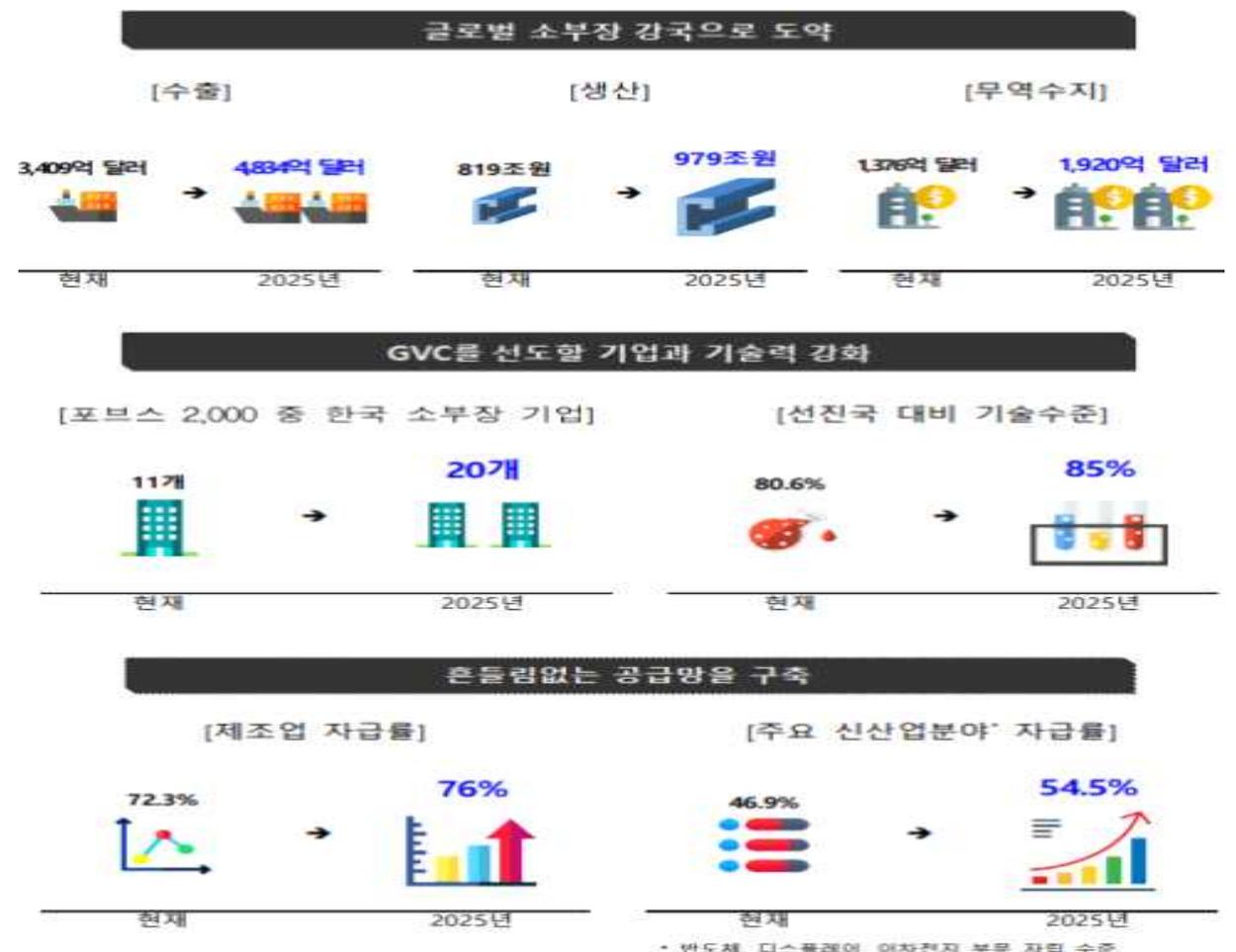
*출처 : 특허정보넷 키프리스, 특허청, 한국기업데이터(주) 재가공

■ 소재, 부품, 장비 산업 경쟁력 강화 정책 추진

정부는 일본 수출 규제 이후 100대 품목 소재, 부품, 장비를 핵심 품목으로 지정하고 예산, 컨설팅 등을 지원하여 관련 산업의 국산화를 집중 추진하고 있는 중이다. 정부는 이에 멈추지 않고 2020년 7월 9일 ‘소부장 2.0 전략’ 을 내놓아 일본 의존도가 높은 100개 품목에서 더욱 확대하여, 중국, 미국, 유럽 등에 의존하는 품목들도 포함하여 338개 이상으로 늘렸다.

반도체 등 첨단형 158개 품목, 자동차, 전자 전기 등 범용형 180개 품목이 선정되었고, 바이오, 환경, 로봇 등 신산업에서 추가 품목을 지정할 계획이며, 산업 가치사슬에 필수적인 핵심전략 기술 분야에 잠재적 역량을 갖춘 소부장 으뜸기업 100곳도 육성할 계획이다. 또한, 정부는 용인, 청주, 천안, 전주, 창원 지역을 소부장 특화단지로 지정하여 역량 집중지원을 진행하고 있고, 동사의 사업장 중 창원 본사는 창원 소부장 특화단지에 위치해 사업을 영위하고 있다.

[그림 9] 2025 소재, 부품, 장비 산업 발전전망



*출처 : 산업통상자원부

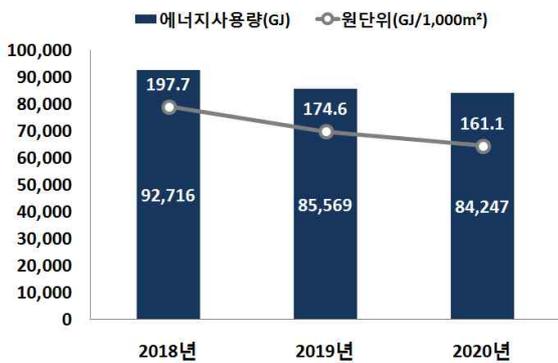
■ 동사의 ESG 활동

동사는 환경(E) 부문에서 환경(대기, 수질, 폐기물, 폐수 등) 관련 법규 준수를 위한 ‘ISO 14001(환경경영시스템)’ 기반 환경경영 전담조직(환경안전팀)을 운영하고 있으며, 방침 및 목표 수립, 모니터링 실시, 환경 및 안전, 보건을 핵심 주제로 하여 오염방지, 자원이용, 안전보건,

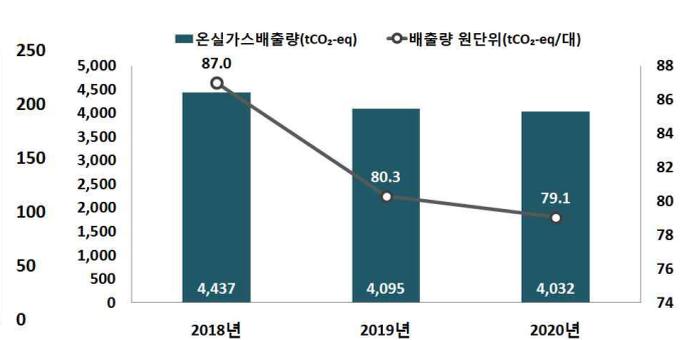
작업환경 교육을 주기적으로 실시하고 있다.

또한, 기후변화대응 측면에서 에너지 사용은 전기가 대부분이며, 동사의 2020년 에너지사용량은 84,247GJ, 온실가스배출량은 4,032tCO₂-eq로, 모두 감소로 개선추세인데, 온실가스배출량 원단위가 2018년 80.3tCO₂-eq/대에서 2020년 79.1tCO₂-eq/대로 약 1.54% 가량 감소하여 개선추세를 보이고 있다.

[그림 10] 연도별 에너지사용량 및 원단위



[그림 11] 연도별 온실가스배출량 및 원단위



*출처 : 동사, 한국기업데이터(주) 재가공

동사는 사회(S) 부문에서 가장 큰 성과를 이룩하고 있다. 디지털화, 기술변화에 따라 취업, 양질의 일자리, 창업 활동에 필요한 전문기술 및 직업기술 등 모두를 위한 양질의 교육에 대하여, 경남대학교와의 가족회사 MOU 협약을 맺고 IPP 및 LINC+ 현장실습과 전문기술 및 직업기술 등에 대한 인재양성을 위한 장학금을 제공하고 있고, 2021년 4월 금속노조 경남지부 성우지회와의 산업전환협약을 합의하여 고용안정 및 양질의 일자리 확보에 대한 제공을 추진하고 있다.

지배구조(G)의 경우, 최근 3개년 연속 주식배당, 현금배당(연평균 1.10%)으로 주주가치 환원에 힘쓰고 있으며, 또한, 상장회사로서의 공시 의무를 준수하고 있고, 홈페이지에 최신자료와 회사소개 영상 등을 게시하는 등 이해관계자의 권익보호를 위한 노력을 일정 수준 전개하고 있는 것으로 판단된다.